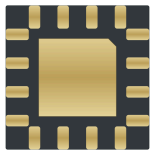
100–20000 MHz 射频开关IC — SP3T; TTL

LCI-SW-100-20000-SP3T-C · 100–20000 MHz · 射频开关IC.

RF 电气表参数: SP3T; 插入损耗 -3.1 dB (典型值); 隔离度 50 dB (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C.

QFN16 2.5 × 2.5 mm



RF端口需外加隔直电容。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 2

RF1: 12

RF2: 10

RF3: 8

VEE: 4, 16

B1: 5, 15

B2: 6, 14

GND: 1, 3, 7, 9, 11, 13

封装外形尺寸: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

RF 特性 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	100	-	20000	MHz
插入损耗	IL	-	-3.1	-	dB
隔离度	ISO	-	50	-	dB
输入/输出驻波比 (导通)	-	-	1.14	-	-
输入/输出驻波比 (关断)	-	-	1.4	-	-

直流偏置与电流 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
负电源电压	-	-5.3	-5	-4.7	V
负电源静态电流	-	-	0.003	-	A
输入驱动电流 [1]	-	-	0.0002	-	A
输入高电平电压	-	4	-	5	V
输入低电平电压	-	0	-	0.4	V

[1] VIH = 5 V; TTL

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	2.5 × 2.5 × 0.75	mm

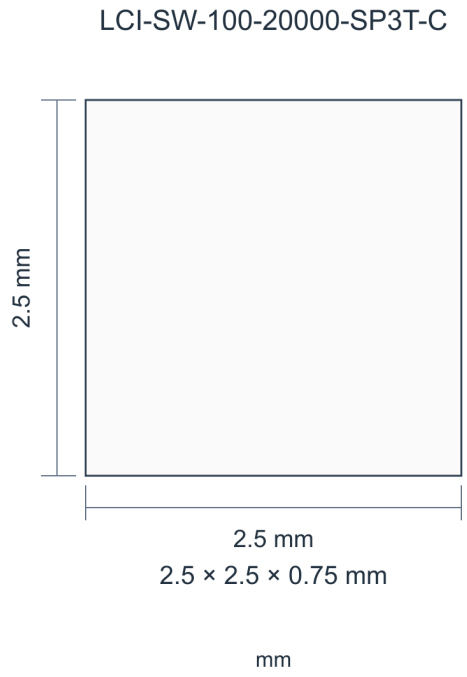
当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

集成说明

QFN16 2.5 × 2.5 mm RF端口需外加隔直电容。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 2 RF1: 12 RF2: 10 RF3: 8 VEE: 4, 16 B1: 5, 15 B2: 6, 14 GND: 1, 3, 7, 9, 11, 13

机械外形尺寸图

安装尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，安装时请参照完整安装图。



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。